

平成20年9月期 中間決算説明会



Automobile Industry



Electronics Industry

May 13, 2008

1/30



平成20年9月期中間
業績結果について



2/30

<連結>



平成20年9月期中間決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

■ 売上高の増加

<事業別>

	20/9期中間	19/9期中間	増減額	増減率
売上高	24,213	20,980	+3,232	+15.4%
売上総利益	6,930	5,833	+1,096	+18.8%
売上総利益率	28.6%	27.8%		+0.8P
販管費	3,520	3,364	+155	+4.6%
販管費率	14.5%	16.0%		△1.5P
営業利益	3,409	2,468	+940	+38.1%
営業利益率	14.1%	11.8%		+2.3P
経常利益	3,543	2,668	+874	+32.8%
経常利益率	14.6%	12.7%		+1.9P
当期純利益	2,031	1,666	+365	+21.9%
当期純利益率	8.4%	8.0%		+0.4P

抵抗溶接
BRICsなど、新興国向け設備投資
獲得により売上増加
(牽引は、日本・中国・韓国)

平面研磨
シリコンウェーハや先端素材各社への
売上が大幅に増加

■ 営業・経常利益の増加

抵抗溶接・平面研磨両事業
売上増加に伴い収益拡大



3/30

<連結>



平成20年9月期中間決算概要-②

連結損益計算書

■ セグメント別損益

(単位 百万円)

	抵抗溶接	増減額	レーザー	増減額	平面研磨	増減額	合計	増減額
売上高	10,718	+738	236	+91	13,257	+2,402	24,213	+3,232
売上総利益	2,931	+295	49	+31	3,949	+770	6,930	+1,096
売上総利益率	27.3%	+0.9P	20.7%	+8.4P	29.8%	+0.5P	28.6%	+0.8P
販管費	1,792	+101	60	△8	1,667	+62	3,520	+155
販管費率	16.7%	△0.2P	25.5%	△22.2P	12.6%	△2.2P	14.5%	△1.5P
営業利益	1,139	+193	△11	+40	2,281	+707	3,409	+940
営業利益率	10.6%	+1.2P	△4.7%	+30.6P	17.2%	+2.7P	14.1%	+2.3P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

4/30

<連結>



平成20年9月期中間決算概要-③

連結損益計算書

■ 販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	20/9期中間		19/9期中間		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	1,698	7.0%	1,721	8.2%	△22
減価償却費	151	0.6%	203	1.0%	△52
運送費	397	1.6%	327	1.6%	+69
旅費交通費	241	1.0%	260	1.2%	△19
研究開発費	215	0.9%	73	0.3%	+142
その他	816	3.4%	778	3.7%	+38
合計	3,520	14.5%	3,364	16.0%	+155



5/30

<連結>



平成20年9月期中間決算概要-④

営業外損益

再投資税額還付金 → 182百万円
為替差損 → 174百万円

法人税等

税効果適用後の実効税率 → 40.9% (19/9中間 35.9%)



6/30

<連結>



平成20年9月期中間決算概要-⑤

連結貸借対照表

(単位:百万円)

資産	20/9期中間		19/9期		増減	負債純資産	20/9期中間		19/9期		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	31,557	73.4%	33,347	72.9%	△1,790	流動負債	17,446	40.6%	20,407	44.7%	△2,961
有形固定資産	9,233	21.5%	9,465	20.7%	△231	固定負債	563	1.3%	970	2.1%	△407
無形固定資産	237	0.6%	256	0.6%	△19	(有利子負債)	(4,625)	(10.8%)	(6,728)	(14.7%)	(△2,102)
投資等	1,955	4.5%	2,646	5.8%	△690	純資産	24,973	58.1%	24,337	53.2%	+636
合計	42,984	100.0%	45,716	100.0%	△2,732	合計	42,984	100.0%	45,716	100.0%	△2,732

<主な増減>

現金及び預金	→	647百万円増	(20/9中	6,124百万円	19/9期	5,476百万円)
売掛債権	→	-1,018百万円	(20/9中	13,959百万円	19/9期	14,977百万円)
たな卸資産	→	487百万円増	(20/9中	9,557百万円	19/9期	9,069百万円)
未収入金	→	-1,382百万円	(20/9中	1,282百万円	19/9期	2,664百万円)
買掛債務	→	56百万円増	(20/9中	7,866百万円	19/9期	7,810百万円)
短期借入金	→	-1,936百万円	(20/9中	4,325百万円	19/9期	6,262百万円)



売上債権回収により現預金増加、売掛債権・未収入金・短期借入金等減少

7/30



通期の見通しと グループの展望



8/30

<連結>

連結会社の系統図



OBARA株式会社



抵抗溶接

平面研磨装置

レーザー溶接

スピードファム株式会社

OBARA CORP. USA
 小原（南京）機電有限公司
 小原（上海）有限公司
 韓国小原株式会社
 OBARA (THAILAND) CO., LTD.
 OBARA (MALAYSIA) SDN. BHD.
 洋光産業株式会社
 OBARA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
 OBARA AUSTRALIA PTY. LTD.
 OBARA INDIA PRIVATE LTD.
 LLC "OBARA RUS"

佐久精機株式会社
 SPEEDFAM INC. (台湾)
 SPEEDFAM (INDIA) PVT LTD.
 SPEEDFAM MECHTRONICS (上海)
 SPEEDFAM CORPORATION (USA)
 SpeedFam (BVI) LTD.
 S/Fクリーンシステム株式会社
 SpeedFam NV/SA (ベルギー)
 SPEEDFAM KOREA LTD.



9/30

<連結>



平成20年9月期業績予想（通期連結）

（単位 百万円）

	20/9期予想	19/9期実績	増減額	増減率
売上高	47,000	45,219	+1,780	+3.9%
売上総利益	13,600	12,755	+844	+6.6%
売上総利益率	28.9%	28.2%		+0.7P
販管費	7,700	7,211	+488	+6.8%
販管費率	16.4%	15.9%		+0.5P
営業利益	5,900	5,544	+355	+6.4%
営業利益率	12.6%	12.3%		+0.3P
経常利益	6,100	5,853	+246	+4.2%
経常利益率	13.0%	12.9%		+0.1P
当期純利益	3,850	3,553	+296	+8.3%
当期純利益率	8.2%	7.9%		+0.3P



10/30

<連結>



平成20年9月期予想（上・下半期）

(単位 百万円)

	20/9期 上半期実績	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比
売上高	24,213	+3,232	22,786	△1,452
売上総利益	6,930	+1,096	6,669	△252
売上総利益率	28.6%	+0.8P	29.3%	+0.7P
販管費	3,520	+155	4,179	+333
販管費率	14.5%	△1.5P	18.3%	+2.5P
営業利益	3,409	+940	2,490	△585
営業利益率	14.1%	+2.3P	10.9%	△1.8P
経常利益	3,543	+874	2,556	△628
経常利益率	14.6%	+1.9P	11.2%	△1.9P
当期純利益	2,031	+365	1,818	△69
当期純利益率	8.4%	+0.4P	8.0%	+0.2P



11/30

<連結>



平成20年9月期業績予想（セグメント別）

(単位 百万円)

	抵抗溶接	前同期比	レーザー	前同期比	平面研磨	前同期比	合計	前同期比
売上高	20,000	+109	500	+143	26,500	+1,527	47,000	+1,780
売上総利益	5,350	+372	140	+65	8,110	+405	13,600	+844
売上総利益率	26.8%	+1.7P	28.0%	+7.2P	30.6%	△0.2P	28.9%	+0.7P
販管費	3,750	+108	130	△11	3,820	+396	7,700	+488
販管費率	18.8%	+0.4P	26.0%	△13.7P	14.4%	+0.7P	16.4%	+0.4P
営業利益	1,600	+264	10	+77	4,290	+9	5,900	+355
営業利益率	8.0%	+1.3P	2.0%	+20.6P	16.2%	△1.0P	12.6%	+0.3P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

12/30

<連結>



主な項目の実績と予想

(平成19年9月期実績) (平成20年9月期予想)

◆ 設備投資		
1,628百万円	→	2,280百万円
◆ 減価償却費		
1,122百万円	→	1,200百万円
◆ 研究開発費		
562百万円	→	600百万円
◆ 銅価格		
90万円/ton	→	96万円/ton
◆ 為替想定レート		

\$=110円(1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)

注) 設備投資は有形無形を含む



13/30

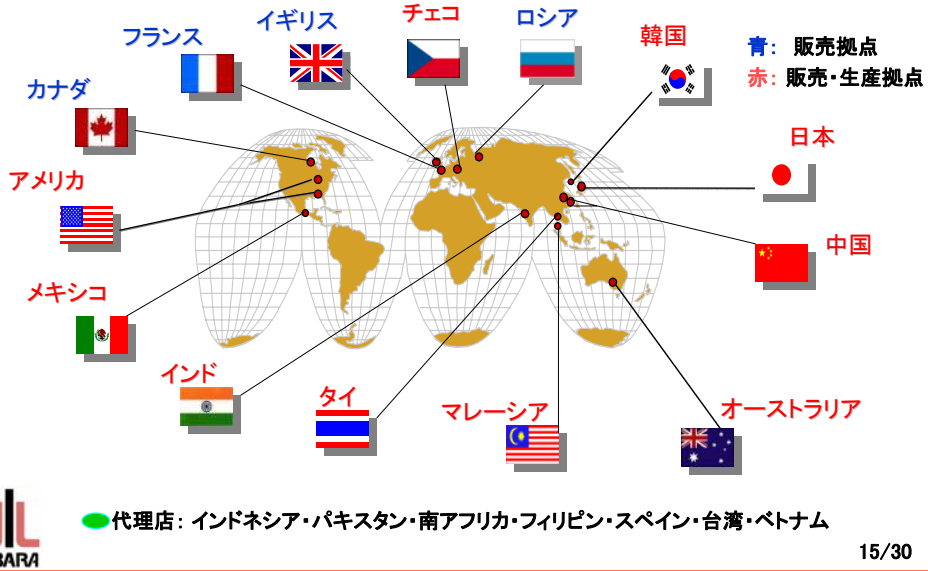
<抵抗溶接連結>



14/30

<抵抗溶接連結>

グローバルネットワーク



<抵抗溶接連結>

主要原材料、銅の値動き



<抵抗溶接連結>

抵抗溶接事業 平成20年9月期業績予想

(単位 百万円)

	20/9期 上半期実績	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比	20/9期 通期予想	前同期比
売上高	10,718	+738	9,281	△629	20,000	+109
売上総利益	2,931	+295	2,418	+77	5,350	+372
売上総利益率	27.3%	+0.9P	26.1%	+2.4P	26.8%	+1.7P
販管費	1,792	+101	1,957	+6	3,750	+108
販管費率	16.7%	△0.2P	21.1%	+1.4P	18.8%	+0.4P
営業利益	1,139	+193	460	+70	1,600	+264
営業利益率	10.6%	+1.2P	5.0%	+1.0P	8.0%	+1.3P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

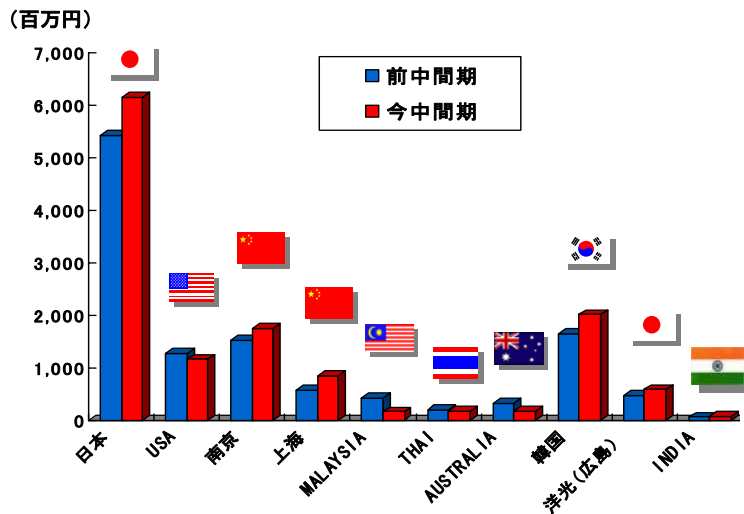


17/30

<抵抗溶接連結>

会社別の売上高実績

(中間期)

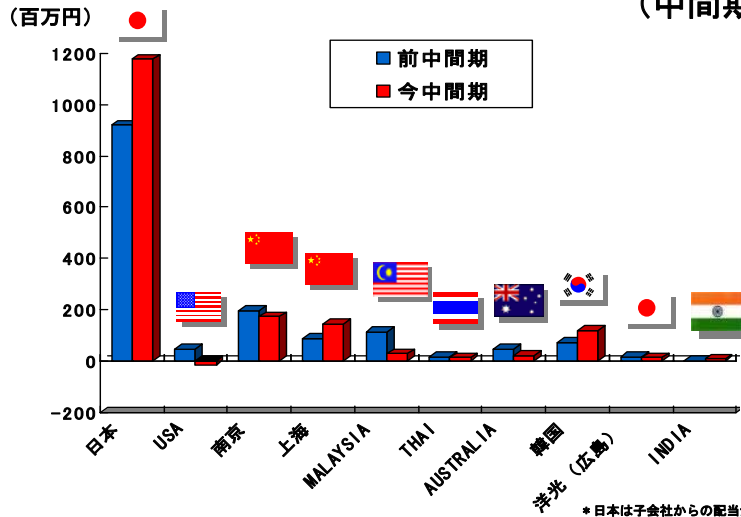


18/30

<抵抗溶接連結>

会社別の当期純利益実績

(中間期)

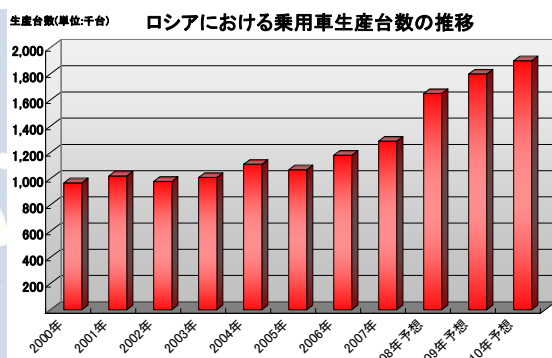


*日本は子会社からの配当金を含む

<抵抗溶接連結>

Topics

ロシアに現地法人設立 (LLC "OBARA RUS")



*予想は、ロシア経済省発表数値に基づき作成

「OBARA RUS 概要」

場所：ロシア連邦 レニングラード州 サンクトペテルブルク市内
 内容：自動車ボディー溶接向けの消耗品販売およびテクニカルサポート拠点
 お客様：現地で生産工場を有する自動車メーカー様 すべてを対象に営業展開
 計画：2010年に年商1億円程度を計画



平面研磨事業の概況



21/30

平面研磨事業の概況

半導体関連の需要回復タイミングを見極め

- ウェーハ不足の緩和により、シリコンウェーハ各社の設備増強に落ち着き感
- ハードディスクドライブ市場において、装置需要が堅調推移

22/30

平面研磨事業 20年9月期業績予想

(単位 百万円)

	20/9期 上半期末績	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比	20/9期 通期予想	前同期比
売上高	13,257	+2,402	13,242	△874	26,500	+1,527
売上総利益	3,949	+770	4,160	△364	8,110	+405
売上総利益率	29.8%	+0.5P	31.4%	△0.6P	30.6%	△0.2P
販管費	1,667	+62	2,152	+329	3,820	+391
販管費率	12.6%	△2.2P	16.3%	+3.3P	14.4%	+0.7P
営業利益	2,281	+707	2,008	△693	4,290	+14
営業利益率	17.2%	+2.7P	15.2%	△4.0P	16.2%	△0.9P

* 上記は参考数値であり、正式な開示数値ではありません

23/30

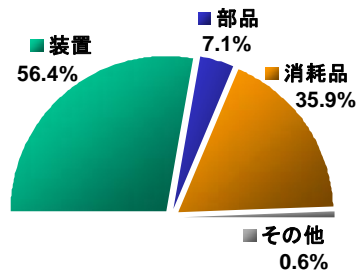
商品群

- ▶ 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

セグメント情報

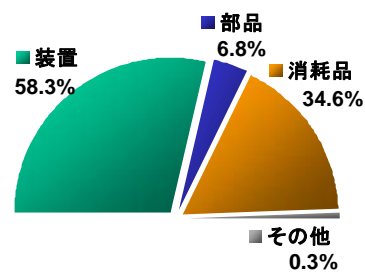
— 商品別売上構成比 —

19年9月期中間



(10,855百万円)

20年9月期中間

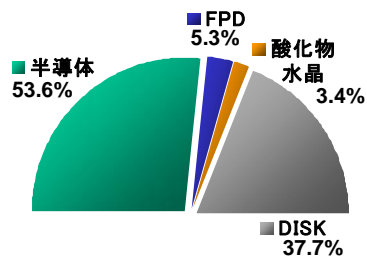


(13,257百万円)

セグメント情報

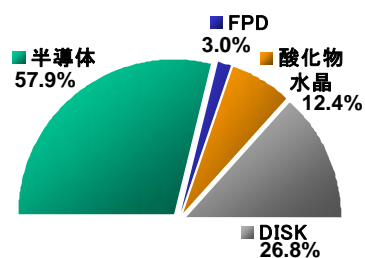
— アプリケーション別売上構成比 —

19年9月期中間



(10,855百万円)

20年9月期中間



(13,257百万円)

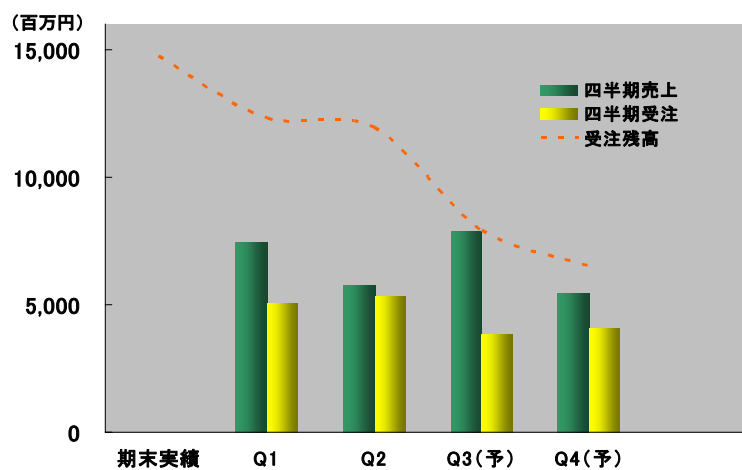
当中間期の傾注項目の結果

- ▶ 最先端 Si ウェーハ向け両面研磨装置
売上計上29億円と受注残高28億円
- ▶ ハードディスク向け装置
売上計上20億円と受注残高47億円
- ▶ 半導体デバイス向けエッジポリシヤ
売上台数 2台と受注残数 0台

平面研磨事業



27/30

受注残高の推移予測



平面研磨事業

28/30




平面研磨事業として

- ▶ 先端要求への技術革新に注力
(シリコンウェーハ向け装置等)
 - 研究開発関連 : 通期 4億円
 - 製造設備の更新等 : 通期 3億円
- ▶ 消耗副資材の販売強化
- ▶ 次々世代への継続的なアプローチ

29/30


<連結>



OBARAグループのVISION

ニッチ市場において

世界一の企業集団を目指す



30/30